

Markt&Technik
DIE ZEITUNG FÜR ELEKTRONIK, KI UND INFORMATIONSTECHNIK

Trade fair newspaper productronica

The leading medium for the trade fair

**Official
premium
partner**



The leading medium
for the leading trade fair

Exclusive benefits that only the official
trade fair newspaper for productronica
2025 can offer you

publication date
18.11.-21.11.2025



Total circulation
Over 130,000 copies

Advertising deadline:
27 October





Die offizielle Messezeitung

Published by **Markt & Technik** AN DER UNIVERSITÄT DUISBURG ESSEN World's leading trade fair for electronics development and production.



Bild: Bundesministerium für Bildung und Forschung

productronica-Premiere: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung präsentiert den »Inno Truck«. Dieser zum Forschungslabor umgebaute LKW soll auf spielerische Weise das Interesse für technologischen Können und gleichzeitig Nachwuchskräfte für technische Berufe begeistern. Der InnoTruck steht zwischen den Hallen A1 und B1.

Highlights

Exhibition Map & Events pp. 4-6

ROI Optimization in Electronics Manufacturing p. 8

Test & Measurement pp. 10-11

Semiconductor Technology pp. 14, 17

PCB Assembly pp. 15-16, 22

Electronics Manufacturing Services p. 18

Soldering pp. 19-20

PCB Inspection p. 23

Visit the WEKA stand at productronica!
Hall A2, Booth 577

New test methods from ERS

Test costs will fall significantly

For the first time, complex ICs can now be tested under voltage and temperature not only in the final test, but also at the wafer-level. This increases the yield and significantly reduces costs. "This makes chiplet-based processors affordable, while simpler microcontrollers for cars can now be produced more cost-effectively," says Klemens Reitinger, CTO of ERS.

Markt & Technik: ERS has so far been very successful with air-cooled chuck systems developed in-house and has consistently emphasized the advantages of this technology compared to liquid-cooled chucks. Just in time for Semicon Europa, ERS is now presenting a new water-cooled chuck here at the fair. Why the change of heart? Klemens Reitinger: This may sound like a change of heart at first, but in fact it is not. We remain convinced that air-cooled thermal chuck systems are the better option for the vast majority of applications, and we basically stick to our philosophy of using air cooling wherever possible. But above all: the fact that the new chucks are liquid-cooled is not the innovation but rather just a by-product, so to speak. So what is the really new development



Klemens Reitinger, CTO of ERS

that ERS is presenting at Semicon Europa? I think the best place to start is at the top level, the application. All manufacturers of

processors and microcontrollers, but in particular manufacturers of high-end CPUs, GPUs and AI processors, regardless of whether they are IDMs or foundries, are facing a huge problem: You cannot perform a full wafer-level test on these ICs. Whether they work or not is only revealed during final test, i.e. after the ICs have been separated. However, being able to sort out faulty ICs only after the final test costs much more than if they could be identified on the wafer in advance. Why is this especially true of the high-end devices? In principle because these devices are no longer integrated monolithically. Instead, manufacturers produce individual functional blocks separately in the most suitable available process technology. These so-called chiplets are then integrated into housing, using advanced packaging techniques. For this to be cost-effective, the chiplets must be known Good Dies. If they can only be tested for their functionality in the package during the fi-

➔ Page 7

»Reinraum-Blase« für den Arbeitsplatz



Bild: Deep Data System

Das von Klepp Absauganlagen vertriebene kompakte Reinraumgerät »DAIR« verbessert die Luftreinheit am Arbeitsplatz. Es hält die Arbeitsflächen frei von Schwebstoffen und erzeugt zugleich eine unsichtbare »Reinraum-Blase« am Arbeitsplatz. Das mobile Absauggerät DAIR wartet mit einer laminaren Reinluftströmung von 0,5-0,6 m/s auf und absorbiert Partikelgrößen > 0,3 µm. Zudem bläst es konstant Reinluft über den Arbeitsplatz, wobei der laminare Luftstrom nicht zu

➔ Seite 9

www.markt-technik.de

Markt & Technik Die offizielle Messezeitung **1**

10 thousand Print copies

Exhibitor distribution

Distribution to all exhibitor stands

Visitor distribution

Exclusive distribution at the entrances on all three days

Trade press stand

Display on all three days

Hotel distribution

Approximately 40 hotels around the exhibition centre



120 thousand

e-paper recipients

National and international
specialist contacts

Supplement

Stand out from traditional advertisements and place your message physically in the hands of readers

Book now



Die offizielle

Messezeitung



Published by Markt & Technik

World's leading trade fair for electronics development and production.



productronica-Premiere: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung präsentiert den „InnoTrack“. Dieser zum Forschungsplatz umgebaute LEW soll auf spielerische Weise das Interesse für Technologie fördern und gleichzeitig Nachwuchskräfte für technische Berufe begeistern. Der InnoTrack steht zwischen den Hallen A2 und B1.

Bild: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Highlights

- Exhibition Map & Events pp. 4-6
- ROI Optimization in Electronics Manufacturing p. 8
- Test & Measurement pp. 10-11
- Semiconductor Technology pp. 14, 17
- PCB Assembly pp. 15-16, 22
- Electronics Manufacturing Services p. 18
- Soldering pp. 19-20
- PCB Inspection p. 23

Visit the WEKA stand at productronica!
Hall A2, Booth 577

New test methods from ERS

Test costs will fall significantly

For the first time, complex ICs can now be tested under voltage and temperature not only in the final test, but also at the wafer-level. This increases the yield and significantly reduces costs. "This makes chiplet-based processors affordable, while simpler microcontrollers for cars can now be produced more cost-effectively," says Klemens Reitingner, CTO of ERS.

Markt & Technik: ERS has so far been very successful with air-cooled chuck systems developed in-house and has consistently emphasized the advantages of this technology compared to liquid-cooled chucks. Just in time for Semicon Europa, ERS is now presenting a new water-cooled chuck here at the fair. Why the change of heart? Klemens Reitingner: This may sound like a change of heart at first, but in fact it is not. We remain convinced that air-cooled thermal chuck systems are the better option for the vast majority of applications, and we basically stick to our philosophy of using air cooling wherever possible. But above all: the fact that the new chucks are liquid-cooled is not the innovation but rather just a by-product, so to speak.

So what is the really new development that ERS is presenting at Semicon Europa? I think the best place to start is at the top level, the application. All manufacturers of processors and microcontrollers, but in particular manufacturers of high-end CPUs, GPUs and AI processors, regardless of whether they are IDMs or foundries, are facing a huge problem: You cannot perform a full wafer-level test on these ICs. Whether they work or not is only revealed during final test, i.e. after the ICs have been separated. However, being able to sort out faulty ICs only after the final test costs much more than if they could be identified on the wafer in advance. Why is this especially true of the high-end devices?

In principle because these devices are no longer integrated monolithically. Instead, manufacturers produce individual functional blocks separately in the most suitable available process technology. These so-called chiplets are then integrated into housing, using advanced packaging techniques. For this to be cost-effective, the chiplets must be Known Good Dies. If they can only be tested for their functionality in the package during the fi-

➔ Page 7



Klemens Reitingner, CTO of ERS

»Reinraum-Blase« für den Arbeitsplatz



Das von Klepp Absauganlagen vertriebene kompakte Reinraumgerät »DAIR« verbessert die Luftreinheit am Arbeitsplatz. Es hält die Arbeitsflächen frei von Schwebstoffen und erzeugt zugleich eine unsichtbare »Reinraum-Blase« am Arbeitsplatz. Das mobile Absauggerät DAIR wartet mit einer laminaren Reifluftströmung von 0,5-0,6 m/s auf und absorbiert Partikelgrößen > 0,3 µm. Zudem bläst es konstant Reifluft über den Arbeitsplatz, wobei der laminare Luftstrom nicht zu

Bild: Klepp Absauganlagen

➔ Seite 9

Markt & Technik Die offizielle Messezeitung 1

Trade fair mirror

Guide trade fair visitors directly to your stand with your standardised advertisement in the trade fair guide. All we need is your company logo and stand details.

790 €

productronica 2021

Messepiegel

73 x 65 mm

Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand	Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand	Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand
Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand	Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand	Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand
Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand	Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand	Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand
Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand	Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand	Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand

Bild: Klepp Absauganlagen

Book now

Prices & Dates

Format	Prices 4c
1/1	€ 10,960
9/16 (Junior Page)	€ 6,490
1/2 portrait or landscape	€ 5,780
1/3 portrait or landscape	€ 3,860
1/4 portrait or landscape	€ 2,960
1/4 2 columns	€ 1,940
1/6 landscape	€ 1,500
1/8 2 columns	€ 800
1/8 4 columns	€ 10.80
1/16 vertical	€ 11,670
Price per mm, 1 column (min. 20 mm)	€ 13,970
2nd US or 4th US	€ 44.80
Title flap	€ 19,540
Single ad mm price (50 to 80 mm)	€ 6,500
Banderole	
Post-it	
Dates	
Publication date	18 November – 21 November 2025
Advertisement deadline	27 October
Deadline for print documents	30 November

*not eligible for discount

DAS PRODUCT HIGHLIGHT

Your product announcement directly in the editorial context, highlighted by your logo and the headline "Product Highlight"

Approx. 650 characters + logo + decorative image.
The layout is done by Componeers.

Print documents by
4 November

Kundenspezifische Gehäuse

Warum modifizierte Gehäuse oft die bessere Wahl sind

Die Anforderungen an Gehäuse sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Während früher standardisierte Lösungen ausreichten, sind heute komplexe, oft kundenspezifische Designs gefragt – freilich ohne die Wirtschaftlichkeit aus den Augen zu verlieren. Wie setzen Hersteller das um?

Der Trend geht weiter eindeutig in Richtung kundenspezifischer Gehäuse, bestätigt Ole Pfoch von Apra Norm. Der Grund dafür liegt in der zunehmenden Spezialisierung elektronischer Geräte, die nicht nur technisch, sondern auch optisch perfekt auf die Anwendung abgestimmt sein müssen. Dies betrifft sowohl die Auswahl der Materialien als auch die Integration von Funktionen wie Display- oder Touchlösungen. Zugleich gewinnen Schutzanforderungen an Bedeutung: Gehäuse müssen heute nicht nur Staub und Wasser abweisen (IP-Schutz), sondern auch stoßfest, UV-beständig und temperaturresistent sein.

Kundenspezifisch oder modifizierter Standard?

Die Individualisierung nach Kundenwunsch (kundenspezifisch) wird häufig als dominanter Allgemeintrend genannt. Faktisch aber nicht, ohne nach der Wirtschaftlichkeit zu fragen: Lässt sich mit modifizierten Lösungen der Kundenwunsch schnell und günstiger erfüllen?

Bopla zum Beispiel setzt erstmalig darauf, bestehende Standardgehäuse an Kundenanforderungen anzupassen. Dies ermögliche eine wirtschaftliche Lösung für den Kunden, vor allem bei kleinen Stückzahlen, erklärt Thomas Lücke, Sales Director von Bopla. Und bestätigt: «Unser Fokus liegt auf modifizierten Standardlösungen, da sie viele Kundenanforderungen ohne hohe Investitionskosten abdecken und schnelle Verfügbarkeit bieten.» Während die Nachfrage nach kundenspezifischen Gehäusen wächst, bleibt der modifizierte Standard für viele Hersteller eine praktikable Alternative. Insbesondere für kleinere Serien ist dies eine wirtschaftliche Lösung. Größere Serien dagegen profitieren von vollständig maßgeschneiderten Designs, da durch

optimierte Produktionskonzepte die Stückkosten gesenkt werden können.

Trotzdem wächst auch bei Bopla die Nachfrage nach vollständig kundenspezifischen Lösungen. Dabei sei die größte Herausforderung, individuelle Lösungen wirtschaftlich umzusetzen. «Besonders bei kleinen Stückzahlen, Lücken. Zudem stehen Hersteller unter ständigem Preisdruck und müssen gleichzeitig steigende regulatorische Anforderungen und damit verbundenen Dokumentationsaufwand bewältigen.

Maximilian Schober von Polyrack nennt ähnliche Herausforderungen: «Je leistungsfähiger die Elektronik, desto komplexer die Anforderungen – sei es in Bezug auf Schutz, Kühlung oder Integration von Schnittstellen. Während Polyrack ebenfalls auf Individualisierung setzt, betont Schober die Schwierigkeiten, die durch Zertifizierungsprozesse entstehen. Änderungen in der Serienfertigung erfordern oft eine erneute Zulassung, was den Entwicklungsaufwand erhöht.

Wärmemanagement als Schlüsselfaktor

Mit der steigenden Rechenleistung wächst auch die Herausforderung des Wärmemanagements. Besonders in lüfterlosen Systemen mit hoher Taktfrequenz müssen Gehäuse Wärme effizient ableiten.

Lisa Pichler von Phoenix Contact erklärt die Integration von Kühlkörpern und ausgeklügeltem Thermomanagement ist essenziell, um Überhitzung zu vermeiden. «Dazu kommt: Passive Kühlung wie optimierte Materialwahl oder Flüssigkühlsysteme.

Produkt-Highlight

Nur 12,5 mm hoch, aber stark!



Für die steigenden Anforderungen an das Wärmemanagement in elektronischen Bauteilen kommt der zuverlässige Radiallüfter LY608 von SEPA zur richtigen Zeit. Mit den Maßen 65 mm x 70 mm x 12,5 mm eignet er sich unter anderem hervorragend zum Entwärmen flacher Gehäuse oder zum Anblasen engmaschiger Kühlkörper (Prozessorkühlung). Er fördert bis zu 11m³ Luft pro Stunde und baut im Extremfall bis zu 110 Pa Druck auf. Ein besonderes Feature ist der IP-Schutz. Durch eine schutzlackierte Leiterplatte ist es möglich den LY608 mit IP 55 zu liefern.

SEPA Europe, www.sepa-comps.com, Tel. 04324 1049300

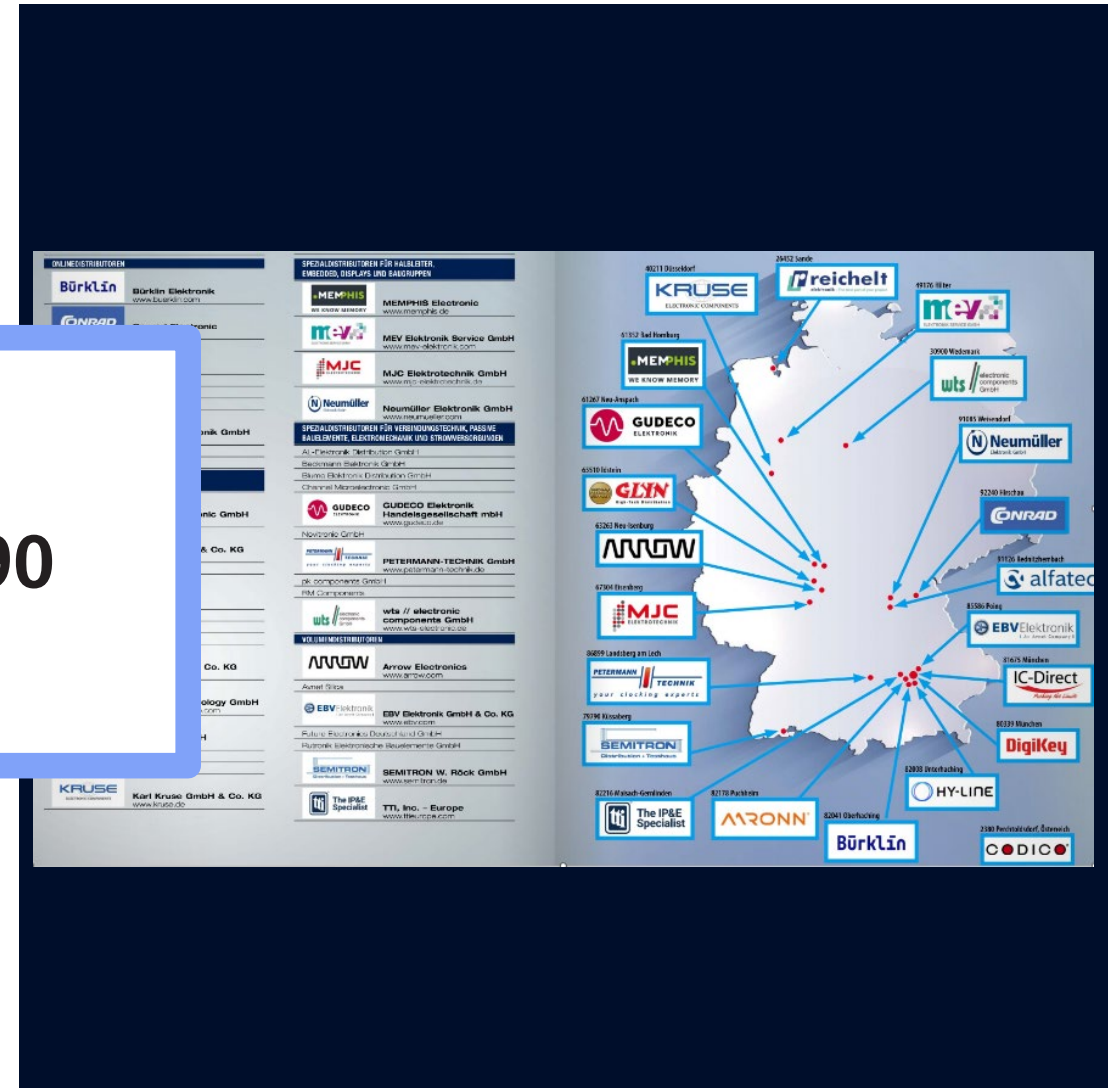


€1,910

THE MOST IMPORTANT electronics manufacturers IN THE COUNTRY

Book your logo in the overview map* "Electronics manufacturers". The overview will appear in the productronica trade fair newspaper with a total circulation of 130,000 copies.

€490



* Minimum of 10 participants



**Over 6 million page
views**

in the last 12 months*

*Source: IVW 30 April 2024 - 1 May 2025

elektroniknet.de

Digital

**Advertise in a credible
environment!**

Newsletter for the trade fair

14 November 2025 Preliminary reports

18 November 2025 Reports

**Approx. 15,000
recipients!**



elektroniknet.de enjoys a high level of credibility and editorial quality within the industry: 91% of users rate the platform as credible, and 98% find the information reliable.

(Source: User survey 2021)



**Trade fair edition
for productronica**

**Markt&Technik 45
on 14 November 2025**

**Advertising deadline 31 October
Printing deadline: 4 November**



Markt&Technik

Print

Attract attention!

The trade fair edition and the productronica trade fair newspaper are available in the exhibition halls. In addition, the hall plan allows visitors to be directed straight to your stand.



Video production

Optional promotion
via our channels

€ 2,490
(non-discountable)

- Brief telephone briefing
- Max. 60 minutes of filming time at your trade fair stand
- Post-production and editing of the clip until customer approval for a clip with a maximum length of 5 minutes
- Including camera and sound for web quality in Full HD / 4K
- Publication of the video in the media library
- Unrestricted use of the video material



elektroniknet.de

Trade fair clip

Get more out of your trade fair appearance!

Take advantage of your trade fair appearance and have a professional video created to capture your trade fair success or new products in sound and vision.

Awareness lead package for the trade fair

We bring our visitors to your stand

Visitors to the Componeers stand can look forward to our wheel of fortune with lots of great prizes.

A sure-fire visitor magnet and the perfect opportunity for you to advertise with your logo before, during and after the trade fair. Once you have confirmed your participation, we will integrate your company logo into all print and online advertising measures.

BEFORE THE TRADE FAIR

Online banner:

- Mentioned by name as a partner with your logo on elektroniknet.de and in at least 5 newsletters
- Approximately 15,000 recipients per newsletter

Print advertisement:

- Markt&Technik 45, total circulation approx. 38,000
- Productronica trade fair newspaper, total circulation approx. 130,000

DURING THE TRADE FAIR

- **Logo presence** on the wheel of fortune
- **Logo presence** on roll-ups for advertising
- Partners provide prizes (approx. 500 items) for the prize draw (in consultation with Componeers)

AFTER THE TRADE FAIR

- Mailing to all participants with the names of the partners and their logos



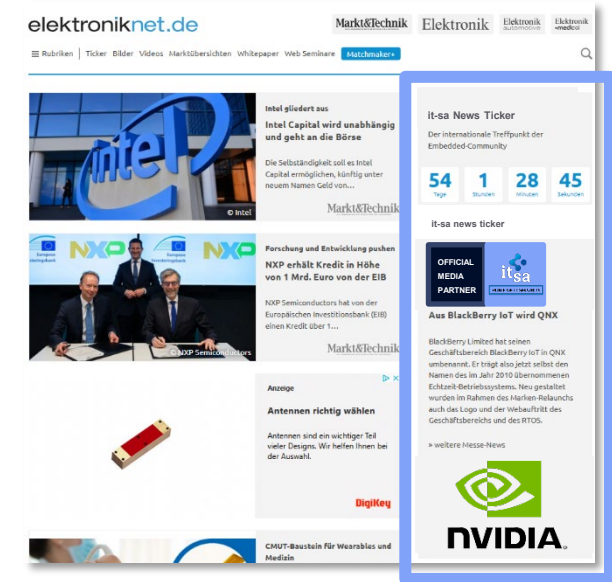
2,990
(non-discountable)

Booking deadline for advertising package
24 October

Countdown and news ticker

Exclusive placements

- Eye-catching placement with increased visibility thanks to prominent placement on the elektroniknet.de homepage
- Target group-specific reach to address potential customers
- Direct link to your homepage
- Increased brand awareness
- Your logo directly linked to productronica



productronica countdown

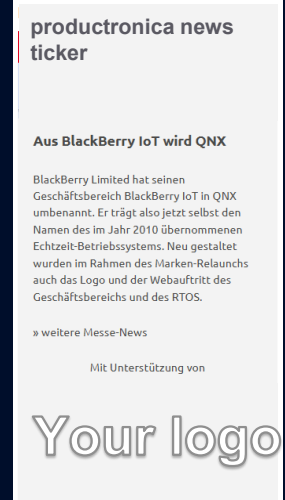
- Exclusive advertising format on the elektroniknet.de homepage
- Your logo with link until 18 November 2025



€4,900

productronica news ticker

- Exclusive advertising format on the elektroniknet.de homepage
- Your logo with link until 21 November 2025



€4,900

Do you have any questions?

We would be happy to advise you!



Carolin Schlüter

Sales Director Electronics

+49 89 25556-1570

cschlueter@componeers.net



Christian Stadler

Sales Director New Electronics

+49 89 25556-1375

cstadler@componeers.net



Malina Colombo

Key Account Manager

+49 89 25556-1382

mcolombo@componeers.net



Martina Greulich

Key Account Manager

+49 89 25556-1576

mgreulich@componeers.net



Emilia Dietrich

Account Manager

+49 89 25556-1574

edietrich@componeers.net



Rosie Böhm

Advertising assistant

+49 89 25556-1307

rboehm@componeers.net